

mSAP

改良半加成法工艺流程

对于细线路而言, mSAP是一种经济高效的工艺流程来帮助达成高度自动化, 高产量和精益生产。MacDermid Alpha可提供一个涵盖了每个重要工艺的组合方案。

减铜

CircuEtch 100

图形电镀填孔

MacuSpec™ VF-TH

雷射钻孔前处理

MultiBond™ 500

剥干膜

UltraStrip LDI

雷射钻孔后处理

CoreClean

差异性蚀刻

CircuEtch 300

初级金属化

Systek™ Desmear
Shadow® LE, Eclipse™ LE
M-Copper® Series

内层压合前处理

M-Speed HF

防焊绿油前处理

MultiPrep 200

干膜前处理

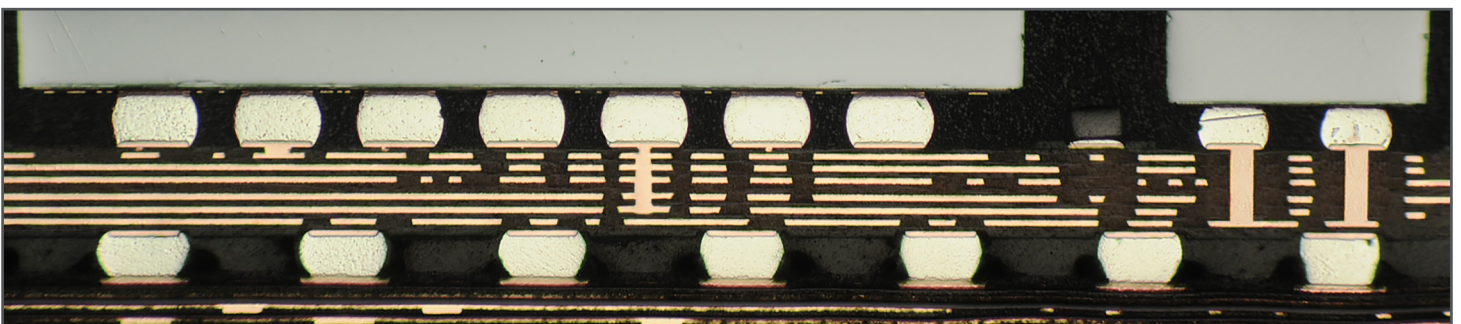
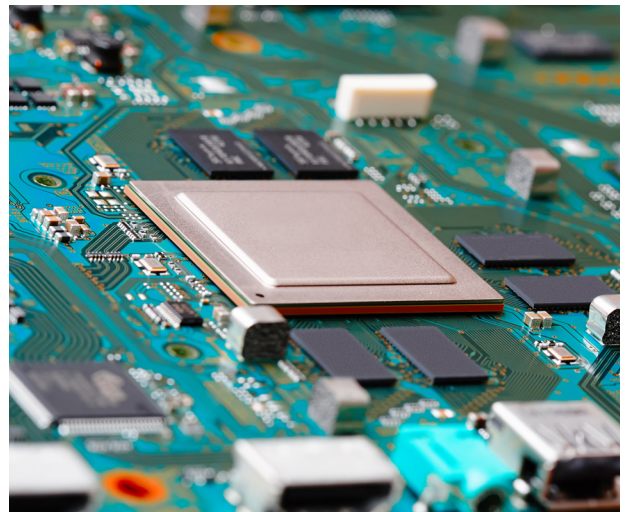
MultiPrep 200

最终表面处理

ENTEK® PLUS HT
Affinity™ ENIG/ENEPIG

干膜显影剂

Developer 45 Plus



MacDermid Enthone 为 MacDermid Alpha Electronics Solutions 旗下的产品品牌名称。© 2022 MacDermid, Inc及其集团附属公司版权所有。标识有“(R)”和“TM”是MacDermid, Inc及其集团附属公司在美国和/或其他国家/地区的注册商标或商标。